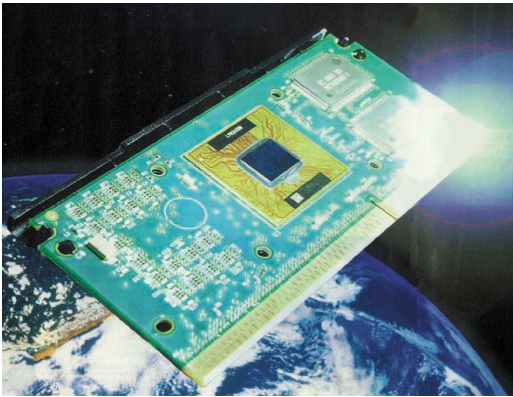


所属・職・氏名	岩手大学工学部 応用化学科 展開化学 教授・森 邦夫
シーズ名	ビルドアップ配線板
シーズの概要	プリント配線基盤の銅配線幅は昨日の多様化によりますます狭く、かつ表面効果を抑制するため銅配線表面も平滑性が要求されるようになってきた。この目的を達成するためには平滑銅表面と樹脂が加熱圧着下で接着することが必要である。そこで、平滑銅表面をトリアジンチオールで処理し、これと、エポキシ樹脂を圧着したところビルドアップ配線板の製造が可能となった。 
その他参考資料	
共同研究機関・企業	(株) 東亜電化 (盛岡)
特許(出願)番号	